



平成 29 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 T O W A 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 岡田 博和
(コード番号 6315 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長
蒲生 喜代重
TEL (075) 692 - 0251

T O W A グループ第 2 次中期経営計画 (2017 年度～2019 年度) について

当社グループは、第 2 次中期経営計画 (2017 年度～2019 年度) を策定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 2 次中期経営計画について

当社は、2014 年 (平成 26 年) に「ものづくり企業の真価に挑む」をテーマに“既存事業の伸張・市場シェアアップ”と“コア技術の応用展開による「新たな市場」の創造”により、10 年後には売上高 500 億円、営業利益率 16% の達成を目指す長期経営ビジョン「T O W A 1 0 年ビジョン」を発表いたしました。

そして「T O W A 1 0 年ビジョン」を具現化するマイルストーンとしての第 1 次中期経営計画 (2014 年度～2016 年度) では、「成長戦略」と「基盤強化」の 2 つのアプローチをベースに各戦略や方策に取り組んで参りました。その結果、第 1 次中期経営計画の最終年度である 2017 年 3 月期の連結業績予想^{※1}は計画を大きく上回る見込みとなり、第 2 次中期経営計画に向けて確固たる礎を構築することができました。

2017 年 4 月から始まる第 2 次中期経営計画の 3 ヶ年は「T O W A 1 0 年ビジョン」を達成する上で最も重要な時期と位置づけております。そこで、当社は「挑戦」と「飛躍」を合言葉として、IoT (モノのインターネット) や自動運転技術、AI (人工知能) 等の様々な用途で拡大が期待される半導体市場で更なる優位性を確保し高い市場シェアを維持し続けるための諸施策と、創造の力によるコア技術を応用展開した新たな市場への取り組みを第 2 次中期経営計画として取り纏めました。

※1. 連結業績予想の詳細については、2017 年 (平成 29 年) 2 月 9 日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 第2次中期経営計画（2017年度～2019年度）の概略

(1) テーマ：「エンパワーメントで挑戦と飛躍を」

(2) 事業方針

① 最先端パッケージ市場での更なる優位性の確保と既存パッケージ市場の掘り起こし

半導体製造装置事業においては、コンプレッション装置がスマートフォンやクレジットカード決済端末などで急速に拡大している指紋認証センサーの生産に最適な装置として韓国や台湾の OSAT からの受注が堅調に推移しました。また、サーバーで急速に進むオール・フラッシュ化に必要な 3D-NAND にも当社コンプレッション装置の優位性が認められ採用が進んでいます。当社といたしましては現状に満足することなく、更に顧客ニーズを取り込みながら市場の優位性を確保して参ります。また、トランスファ装置につきましても、引き続きグローバル・サプライ・チェーンを活用した短納期の実現と価格競争力の向上により顧客満足を追求しシェア拡大を図って参ります。

シンギュレーション装置については、ラインナップの充実と競合他社との目に見える差別化で市場シェア拡大を図って参ります。

② 成形品事業の新市場開拓による業績拡大

現在取り組んでおります新事業、特に微細加工技術を活かした TOWA ブランドの新製品を開発し、株式会社バンディックを活用した量産体制を構築することにより売上を伸ばして参ります。同時に、新たな領域での新規受託ビジネスの開拓に努めて参ります。

③ トータル・ソリューション・サービス（TSS）事業と新事業への経営資源投入による収益機会の拡大

TSS 事業は、新たに装置改造、中古機販売、そして IoT による予防保全ビジネスを取り入れ、お客様の生産性をトータルでサポートする体制が整いました。当事業は、100%子会社である株式会社 TOWATEC を核として、今後更にグローバルにサポート・サービス体制を充実させて参ります。また、本年2月に竣工しました蘇州工場の増築スペースの一部にトレーニングセンターを設置し、オペレーション及びメンテナンスを行う現地担当者に実機を用いた教育訓練を行うことで、お客様の生産性向上に向けた取り組みを行って参ります。

当社コア技術に基づき展開しているナノテク、ツール、コーティング等の新事業分野についても、積極的な事業戦略の推進に努めて参ります。第1次中期経営計画で取り組んできた活動を継続し、当社の新たな柱となる事業に育てて参ります。

④ コーポレート・ガバナンスの強化による更なる企業価値の向上

当社は、平成28年6月29日開催の第38回定時株主総会の承認を得て監査等委員会設置会社へと移行いたしました。引き続き多くのステークホルダーの皆様から信頼が得られるように、第2次中期経営計画期間においても取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の透明性・公正性の向上に向け体制を整備して参ります。

3. 業績計画（連結）

（単位：億円）

項目		期別		
		2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
売上高		295	325	355
売上高内訳	半導体製造装置事業	242	260	277
	ファインプラスチック事業	13	15	16
	新事業	40	50	62
営業利益		38	42	46
経常利益		38	42	46
当期純利益		26	29	32

※本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

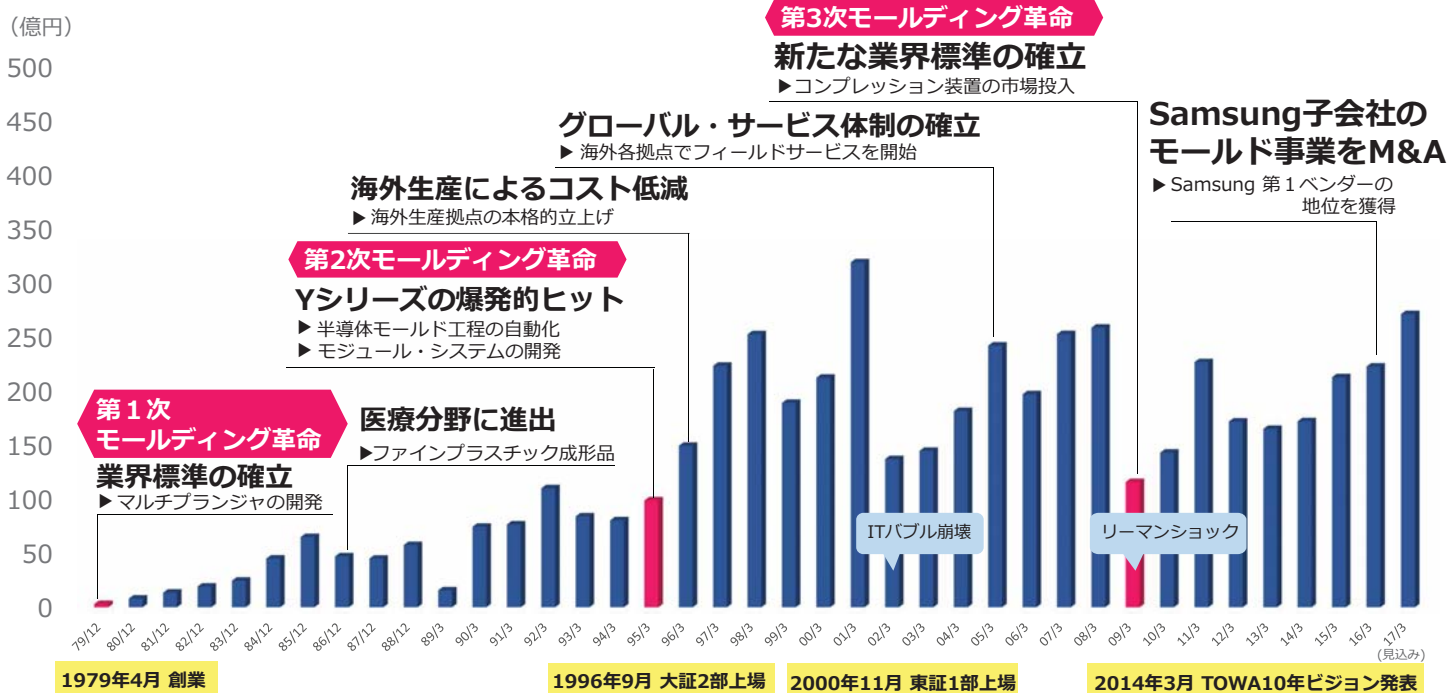
以上

前・中期経営計画振り返り

2014年度～2016年度

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

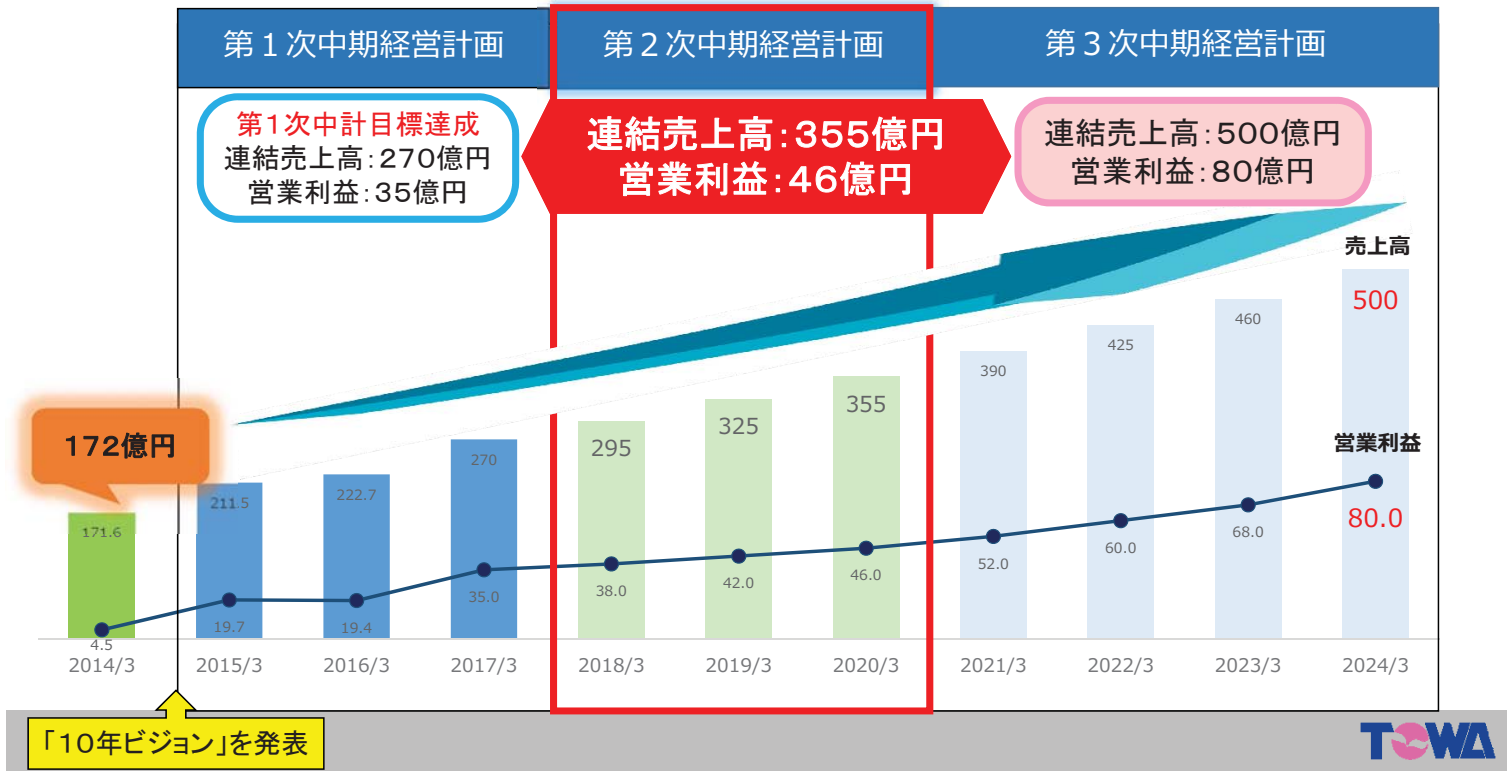
TOWAの歩み



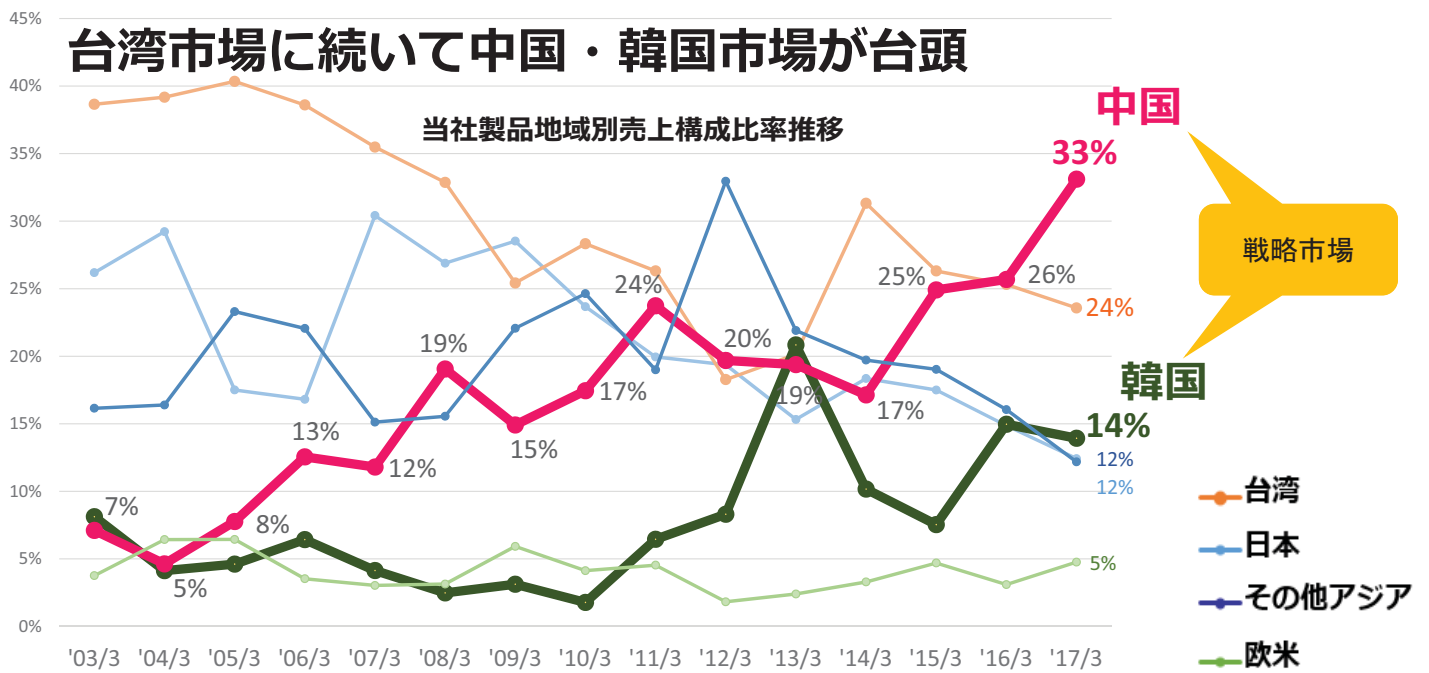
This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION



TOWA10年ビジョンの成長戦略



前・中期経営計画振り返り



前・中期経営計画振り返り

中国での投資実績

建物・設備に16億円投資



TOWA半導体設備（蘇州）有限公司

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION



前・中期経営計画振り返り

韓国での投資実績

Samsung子会社のモールド事業を10億円でM & A



TOWA韓国株式会社

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION



前・中期経営計画振り返り

日本での投資実績

建物・設備に 5 億円投資



TOWA株式会社 九州事業所

建物に 4 億円投資



株式会社バンディック

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION



前・中期経営計画振り返り

前・中期経営計画と実績比較

(単位：億円)

	2015/3期		2016/3期		2017/3期			
	計画	実績	計画	実績	計画	予想	増減額	計画比
売上高	180	212	190	223	210	270	+ 60	+ 28.6%
営業利益	10	20	15	20	21	35	+ 14	+ 66.7%
(営業利益率)	6%	9%	8%	9%	10%	13%		
経常利益	9	23	14	21	20	37	+ 17	+ 85.0%
当期純利益	8	19	13	18	14	※ 35	+ 21	+ 150.0%

※連結業績予想の詳細については、2017年（平成29年）2月9日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION



第2次中期経営計画

2017年度～2019年度

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

中・長期ビジョン 新中期経営計画のテーマ

TOWA10年ビジョン

2014年～2024年

長期テーマ

「ものづくり企業の真価に挑む」

新中期(3カ年)経営計画

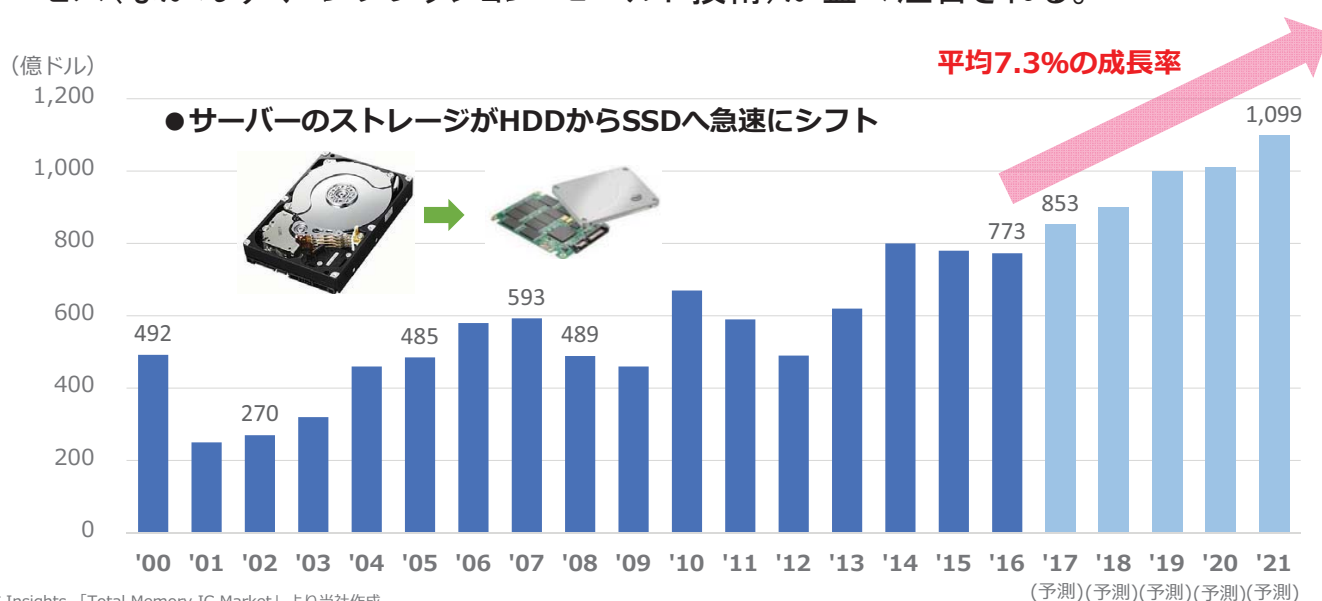
2017年～2019年

テーマ

「エンパワーメントで挑戦と飛躍を」

メモリーIC市場規模予測

更なる微細化、高密度化・高機能化が進み、実装技術のキー・テクノロジーとしてモールド・プロセス(なかんずくコンプレッション・モールド技術)が益々注目される。



This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION



第2次中期（3カ年）経営計画

事業方針

1. 最先端パッケージ市場での更なる優位性の確保と既存パッケージ市場の掘り起こし
2. 成形品事業の新市場開拓による業績拡大
3. トータル・ソリューション・サービス（TSS）事業と新事業への経営資源投入による収益機会の拡大
4. コーポレート・ガバナンスの強化による更なる企業価値の向上



第2次中期（3カ年）経営計画

(単位：億円)

		2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
売	上 高	295	325	355
売 上 高 内 訳	半 導 体 製 造 装 置 事 業	242	260	277
	フ ァ イ ン プ ラ ス チ ッ ク 事 業	13	15	16
	新 事 業	40	50	62
営	業 利 益	38	42	46
経	常 利 益	38	42	46
当	期 純 利 益	26	29	32

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

